

FOB BONDING LINE



技術規格

1	PCB tary盤供料
2	壓合精度 X,Y $\pm 20\mu\text{m}$
3	溫度設定RC~399°C
4	壓合壓力5~60kg/cm
5	Tact Time 12sec/pcs

設備特性與優點

PANEL從前裝置自動排入和傳輸的PCB連接完整面板上執行一系列ACF貼合,透過壓力&溫度進行高精度粘合作業。